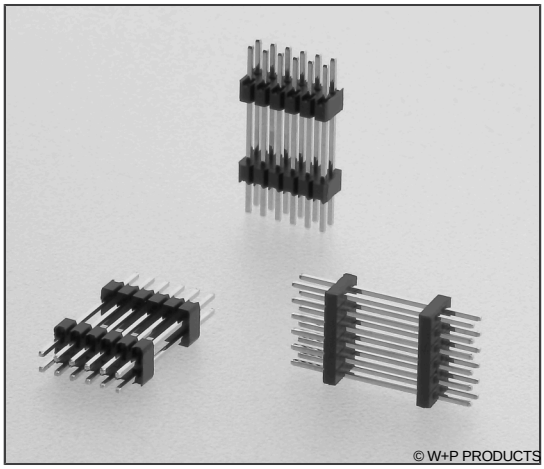
751

Sandwich-Stiftleisten RM 1,27mm, 2-reihig

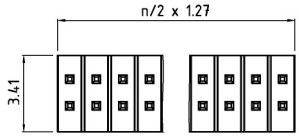
Dual Body Pin Headers, 1.27mm Pitch, Double Row

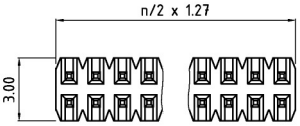
Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung
Contact Material	*0.40mm square pin, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	*> 500 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	*500 V AC*
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	*250 V AC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*

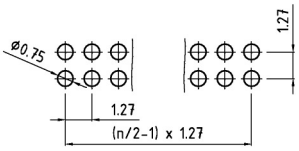


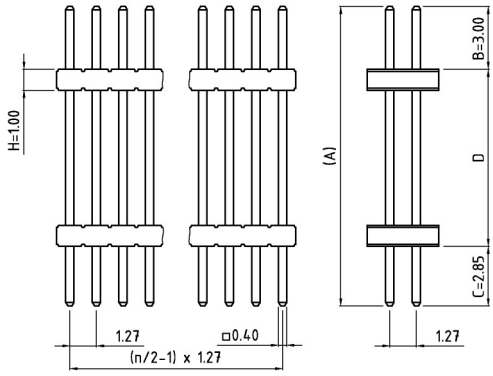
Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
605 713 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more

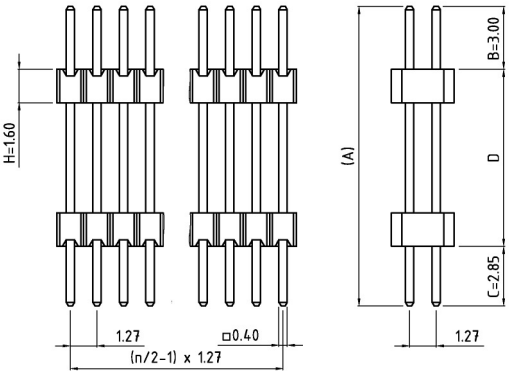




PCB Layout







Series	***Contacts****	***Dimensions****	***Insulator Height****	***Plating****
751	**040**	**20**	**10**	**50**
	004-100 Zweireihig *Double row*	**20** A=14,30 D=8,45mm **30** A=15,00 D=9,15mm **A/B/C** Kundenspezifisch A max. 35,0mm; B/C max. 15,0mm *Customer-specific* *A max. 35,0mm; B/C max. 15,0mm*	**10** H=1,00mm **16** H=1,60mm	**00** Vergoldet *Gold plated* **50** Verzinnt *Tin plated* **60** Sel. Au/Sn *Duplex plating*

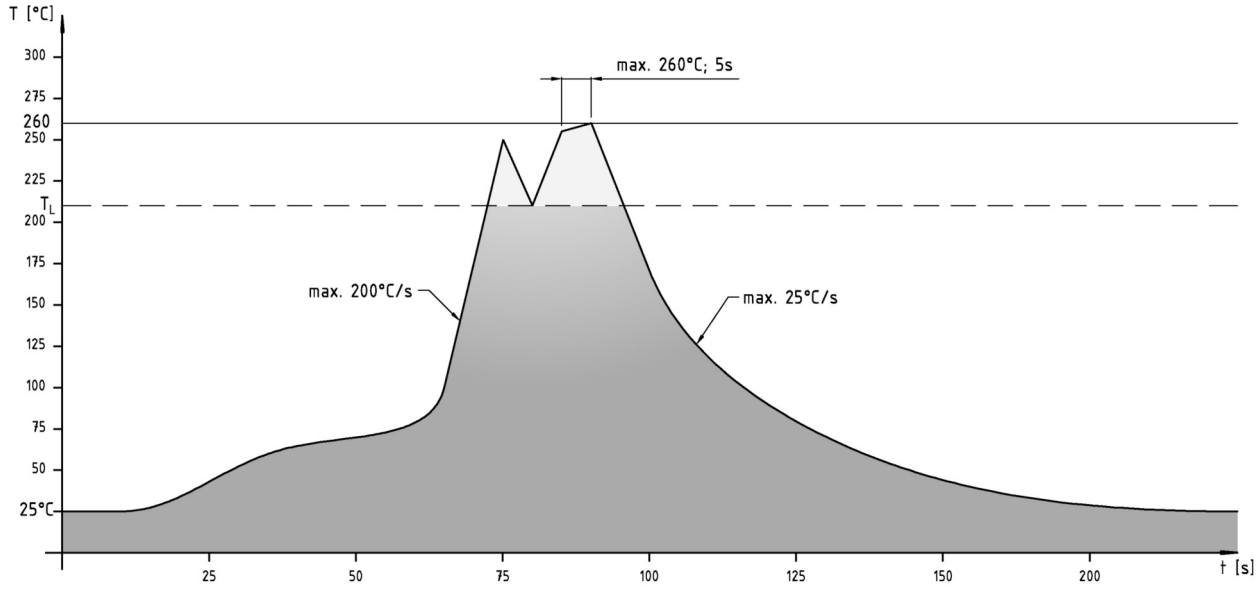
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

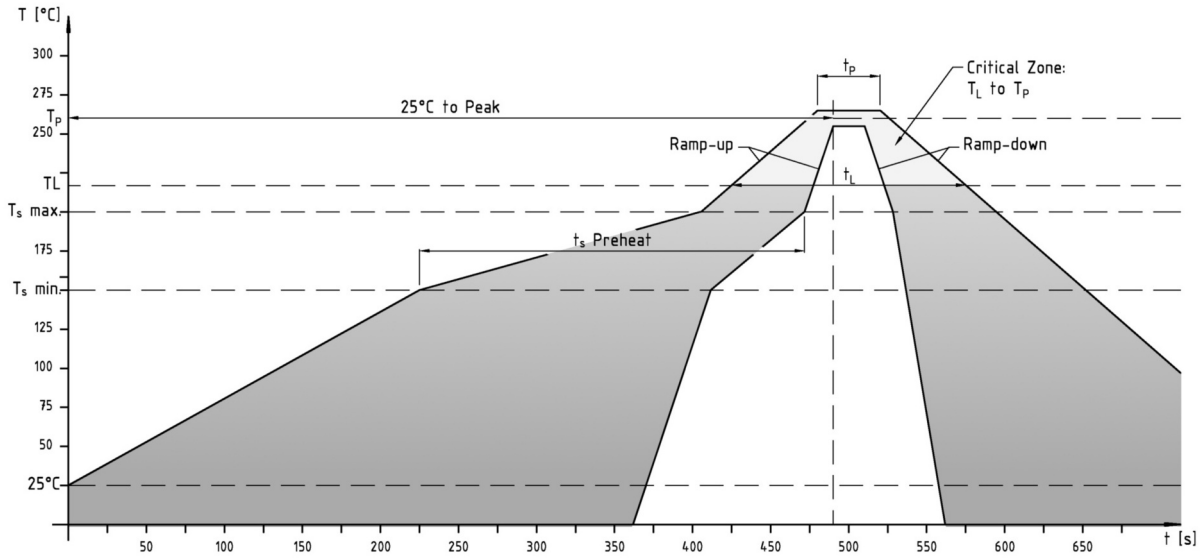


Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	**Key Values**
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*